



平成18年3月31日

各 位

会 社 名 T O W A 株式会社  
コード番号 6315 (東証・大証1部)  
問 合 せ 先 常務取締役経営企画室長  
河原 洋逸  
TEL (075) 692 - 0251

### 中期経営計画「Challenge30」の策定について

当社は、昨年9月から創業者である坂東和彦が代表取締役会長兼社長に復帰して全社一丸となって業績の立直しに取り組んでおりますが、今期業績の見通しが創業来かつてなく厳しいものとなり、コンペチターとの競合により低下している収益性、減損会計により脆弱化した財務体質の改善が急務となっております。

これらを改革していくため、2006年4月から2009年3月までの3年間を対象期間とする新たな中期経営計画を策定し業績回復に取り組むことといたしました。

当社は2009年4月に創立30周年の節目を迎えることもあって、中期経営計画を「Challenge30」と名づけ、今回策定した計画を構造改革として確実に遂行して恒久的な収益体質への転換と、コア・コンピタンスによる製品開発力の強化を実現し、中長期にわたる成長と企業価値の向上をもって、株主様をはじめとするステークホルダーの方々からの信頼回復に努めてまいります。

### 記

#### 1. 中期経営指針

当社は、中期経営計画「Challenge30」の方向性を明確にするため、中期経営指針として次のとおり定めました。

#### 中期経営指針

当社のコア・コンピタンスたる「金型関連技術」、「モノづくり」への原点回帰により収益体質を確立し、「PMシリーズ」をはじめ新製品を世界市場へ投入することによって新たな成長路線を構築する。

当社は、超精密金型を創り出してきた「金型関連技術」がコア・コンピタンス（当社の原点であり、高品質なモノをより安く、お客様が求める時期にお届けする事がメーカーの使命＝モノづくりの原点）であると考えております。この原点に立ち戻って、やや広げすぎた事業領域を整理し、コア・コンピタンスを活かした事業に集中して、QCDの最適化を図り、収益体質を確立してまいります。

また、「薄型化・微細化・多段化」をテーマに技術革新が続く半導体パッケージ技術の未来を見据え、市場ニーズを先取りするソリューション提案型の開発・生産・販売戦略に取り組んでまいります。

その第一弾となる革新的新製品「PMシリーズ」は、当社が独自開発したダブルレイヤー方式の採用によって当社従来製品比で設置面積を30%縮小、パッケージの樹脂材料使用量を20～30%削減し、COO(Cost of Ownership)の大幅削減に貢献できる製品としてリリースいたします。

当社は、お客様が求めるソリューション提案型製品を積極的に市場投入することで、半導体産業の発展に寄与し、新たな成長を続けようと考えております。

## 2. 中期経営計画の基本骨子

当社は、中期経営指針に基づき中期経営計画を立案し、その骨子として、次の七項目に要約いたしました。

### (1) 事業ポートフォリオの見直し

事業内容をモールドィング分野とそれに連なるシンギュレーション分野に特化

LED市場をはじめとして成長分野へコア・コンピタンスを展開

新素材等の開発による新事業領域への開拓

選択と集中によって、事業領域を当社独自のコア・コンピタンスに深く関わるモールドィング分野とシンギュレーション分野に絞り込んだうえで、社内リソース(ヒト・モノ・カネ)を集中投資し、市場ニーズを先取りした新製品開発を進めてまいります。

また、コア・コンピタンスを中心に培われてきた技術を活かして、半導体以外の分野での事業領域の開拓により事業構成を変革させ、特に今後大きな市場拡大が予想されるLED市場については、売上高構成比率を引き上げてまいります。

### (2) 販売戦略の強化

新製品「PMシリーズ」によるシェア拡大と製品差別化競争への転換

世界主要IDM上位10社と台湾系を中心とした大手サブコンの囲い込み強化

台湾市場に加え、中国市場と東南アジア市場を重点地域とした営業展開

ウォータージェットを新たに加え、シンギュレーション装置分野のシェア奪還

今後急速に伸びると予想されるLED市場への製品投入

新素材を既存市場および電子部品全般の事業領域にも展開

SIP(System In Package)、多段スタック、Low-Kなど最先端技術に対するソリューション提案型営業を展開し、従来の主要顧客である大手サブコンに加え、世界主要IDM上位10社を中心として顧客の囲い込みを強化することを基本方針といたします。

今後の市場拡大と台湾資本の大手サブコンの進出が見込まれる中国市場並びに後工程工場が集中している東南アジア市場を重点地域に位置づけ、シェア拡大を目指します。

新製品「PMシリーズ」の発売を機に、リーディングカンパニーとして、高品質による製品差別化競争への転換と従来のモールドィング装置の買換需要を的確に捉えてグローバルシェア50%超を目標として利益体質を確立してまいります。

### (3) QCDの最適化

既存製品のVE(Value Engineering)

海外生産子会社の稼働率向上

海外生産子会社を含めた生産体制の最適化による物流コスト低減とリードタイム短縮

海外資材調達率の引上げ等による資材購入コストの低減

モノづくりの基本要素である品質(Quality)・原価(Cost)・納期(Delivery)について抜本的な見直しを行います。特にコストについては専門プロジェクトを立ち上げ、上記に示しております施策に取り組み、全社横断的な活動に展開してまいります。

### (4) 財務体質の改善

第三者割当増資による株主資本の充実

海外生産子会社の不動産売却による借入金返済

プラットフォーム型先行生産方式の見直しによるたな卸資産の圧縮

取引条件見直しによる売掛金回収期間の短縮

第三者割当増資による株主資本の充実とたな卸資産の圧縮および固定資産の見直しにより有利子負債を削減し、財務体質の改善を急ぎます。海外生産子会社を中心に、膨れ上がった生産設備をスリム化させてまいります。

### (5) 固定費の削減

グループ全体人員20%削減(1,000名体制)

早期退職優遇制度の導入と転籍出向による人員削減(単体400名体制)

TOWA Singapore Mfg.Pte.Ltd.の閉鎖と工場売却

TOWA-Intercon Technology, Inc.の大幅なリストラ

当社グループの収益性回復は、グループ全体での固定費削減が重要課題となっております。海外においては生産子会社の整理縮小、日本国内においては40歳以上の社員を対象にした早期退職優遇制度の導入や転籍出向を行い、2006年3月現在グループ人員1,240名体制（単体450名体制）を2007年3月末までにグループ人員1,000名体制（単体400人体制）へ削減します。今後、ERPの導入やPDMの推進などのIT化推進によって業務効率化・省力化を図り、繁忙期にもこの人員体制でカバーする業務形態といたします。

上記に示しております施策によって、中期経営計画最終年度には固定費総額20億円削減を見込んでおります。

#### (6) 経営責任の明確化

2006年3月期の業績悪化の経営責任を明確にするため、役員退職慰労引当金を全額取り崩すと同時に本制度を廃止いたします。

代表取締役会長兼社長である坂東和彦に対する第三者割当増資により経営責任を内外に表明し、会長兼社長の役員報酬全額返上をはじめ、全役員について10～20%の役員報酬カットを行い、あわせて管理職も応分の給与カットを業績回復の時期まで実施いたします。

#### (7) 企業文化・企業組織の改革

CS(Customer Satisfaction)の徹底的追求

ES(Employee Satisfaction)の高揚

組織の簡素化・フラット化

IT導入による省力化、間接人員の削減

企業として継続性を維持していくうえで、お客様のニーズに対する飽くなき追求心と、従業員の働きがいや意欲の向上が必要不可欠となっております。能力成果型人事制度に基づく公正な人事評価と人材教育に力を注ぎ、活気とチャレンジ精神に満ち溢れた企業文化に変革させるための工夫をまいります。また、迅速な業務の遂行を目的とした組織の簡素フラット化を推進し、間接人員を削減してまいります。

### 3. 計画スケジュールについて

三年度にわたる中期経営計画のスケジュールについて、次のとおり考えております。

#### (1) 2006年度（体質改善の年）

海外生産子会社の整理縮小、グループ人員の削減、たな卸資産の圧縮、IT導入による業務効率化等により固定費削減を最優先課題として体質改善を急ぎます。

PDMの推進による設計工数の削減、部品点数と軸数の削減、部品共有化といった既存製品の量産設計の見直しをはじめ様々なコスト削減策を継続的に行い利益体質を確実にしてまいります。

#### (2) 2007年度（基盤固めの年）

海外子会社整理の全面寄与により収益体質を確固にいたします。「PMシリーズ」本格的投入により量産と拡販が進展し採算性が大きく向上するものと想定しております。

#### (3) 2008年度（飛躍の年）

最終年度としてモールドینگ装置のグローバルシェア拡大とシンギュレーション装置のシェア奪還に加えLED市場の足場を固めるほか、研究中の新素材を「PMシリーズ」をはじめとするモールドینگ装置の主力金型とするほか電子部品全般にわたる事業として新たな柱に加え成長路線を構築してまいります。

#### 4. 経営目標

最終目標年度である2009年3月期には、売上高300億円、経常利益率10%を目指してまいります。

(連結)

(単位:百万円)

項 目		期 別		2005年3月期	2006年3月期	2007年3月期	2008年3月期	2009年3月期
				(実績)	(予想)	(計画)	(計画)	(計画)
売 上 高				24,111	19,000	20,000	24,000	30,000
売 上 高 内 訳	半導体製造用等精密金型			7,893	6,300	6,400	6,600	7,700
	モールドイング装置			8,108	7,900	8,300	9,300	10,100
	LED封止装置			50	200	700	2,000	4,000
	シンギュレーション装置			6,453	3,200	3,500	4,500	6,000
	その他装置			477	300	-	-	-
	ファインプラスチック成形品			1,129	1,100	1,000	1,000	1,000
	新素材関連			-	-	100	600	1,200
経 常 利 益				326	2,700	250	1,500	3,000
当 期 純 利 益				146	5,900	130	1,300	2,700

シンギュレーション装置には、従来半導体製造用等精密金型に分類していましたシンギュレーション金型部品も含めて表示しております。

なお、前記の予想は現時点において入手可能な情報、および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る現時点における仮定を前提としています。従いまして実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性がありますのでご承知おき頂きますようお願いいたします。

以 上